Diotec Semiconductor

BC856 ... BC860

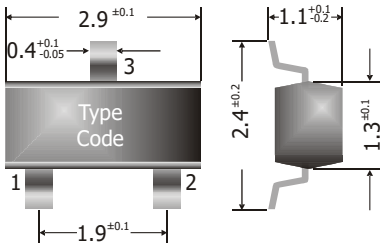
SMD General Purpose PNP Transistors
SMD Universal-PNP-Transistoren

I_C = -100 mA
h_{FE} ~ 180/290/520
T_{jmax} = 150°C

V_{CEO} = -30...-65 V
P_{tot} = 250 mW

Version 2018-02-02

SOT-23 (TO-236)



1 = B 2 = E 3 = C

Dimensions - Maße [mm]

Typical Applications
Signal processing,
Switching, Amplification
Commercial grade [1])

Typische Anwendungen
Signalverarbeitung,
Schalten, Verstärken
Standardausführung [1])

Features
General Purpose
Three current gain groups
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals [1])

Besonderheiten
Universell anwendbar
Drei Stromverstärkungsklassen
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien [1])

Mechanical Data [1])

Taped and reeled	3000 / 7"	Gegurtet auf Rolle
Weight approx.	0.01 g	Gewicht ca.
Case material	UL 94V-0	Gehäusematerial
Solder & assembly conditions	260°C/10s MSL = 1	Löt- und Einbaubedingungen

Mechanische Daten [1])

Type Code			Recommended complementary NPN transistors Empfohlene komplementäre NPN-Transistoren
BC856A = 3A BC856B = 3B BC856C = 3C	BC857A = 3E BC857B = 3F BC857C = 3G BC860B = 3F BC860C = 3G or 4G	BC858A = 3E BC858B = 3F BC858C = 3G BC859A = 3E BC859B = 3F BC859C = 3G or 4C	BC846 ... BC850

Maximum ratings [2]) **Grenzwerte [2])**

			BC856	BC857 BC860	BC858 BC859
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	$-V_{CEO}$	65 V	45 V	30 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	$-V_{CBO}$	80 V	50 V	30 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	$-V_{EBO}$	5 V		
Power dissipation – Verlustleistung		P_{tot}	250 mW [3])		
Collector current – Kollektorstrom	DC	$-I_C$	100 mA		
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		$-I_{CM}$	200 mA		
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_S	-55...+150°C -55...+150°C		

1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben
3 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

© Diotec Semiconductor AG

Characteristics **Kennwerte**

			T_j = 25°C	Min.	Typ.	Max.
DC current gain – Kollektor-Basis-Stromverhältnis						
- V_{CE} = 5 V	- I_C = 10 µA	Group A	h_{FE}	–	90	–
		Group B		–	150	–
		Group C		–	270	–
	- I_C = 2 mA	Group A	h_{FE}	125	180	250
		Group B		220	290	475
		Group C		420	520	800
Collector-Emitter saturation voltage – Kollektor-Sättigungsspannung [1])						
- I_C = 10 mA	- I_B = 0.5 mA		- V_{CEsat}	–	–	300 mV
- I_C = 100 mA	- I_B = 5 mA			–	–	650 mV
Base-Emitter saturation voltage – Basis-Sättigungsspannung [2])						
- I_C = 10 mA	- I_B = 0.5 mA		- V_{BEsat}	–	700 mV	–
- I_C = 100 mA	- I_B = 5 mA			–	900 mV	–
Base-Emitter-voltage – Basis-Emitter-Spannung [2])						
- V_{CE} = 5 V	- I_C = - 2 mA		- V_{BE}	600 mV	–	750 mV
- V_{CE} = 5 V	- I_C = - 10 mA			–	–	820 mV
Collector-Base cutoff current – Kollektor-Basis-Reststrom						
- V_{CE} = 30 V		E open	- I_{CBO}	–	–	15 nA
- V_{CE} = 30 V	T_j = 125°C			–	–	4 µA
Emitter-Base cutoff current						
- V_{EB} = 5 V		C open	- I_{EBO}	–	–	100 nA
Gain-Bandwidth Product – Transitfrequenz						
- V_{CE} = 5 V, - I_C = 10 mA, f = 100 MHz			f_T	100 MHz	–	–
Collector-Base Capacitance – Kollektor-Basis-Kapazität						
- V_{CB} = 10 V, I_E = i_e = 0, f = 1 MHz			C_{CBO}	–	4.5 pF	–
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität						
- V_{EB} = 0.5 V, I_C = i_c = 0, f = 1 MHz			C_{EB0}	–	9 pF	–
Noise figure – Rauschzahl						
- V_{CE} = 5 V, - I_C = 200 µA		BC856 ... BC858	F	–	2 dB	10 dB
R_G = 2 kΩ, f = 1 kHz, Δf = 200 Hz		BC859 ... BC860		–	1.2 dB	4 dB
Thermal resistance junction to ambient Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung			R_{thA}	< 420 K/W [2])		

Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet

1 Tested with pulses t_p = 300 µs, duty cycle ≤ 2% – Gemessen mit Impulsen t_p = 300 µs, Schaltverhältnis ≤ 2%
2 Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

 © Diotec Semiconductor AG